



RE450-LF

- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por un lado 35 µm de Cu
- Sin perforación
- Estañado en caliente (HAL-leadfree) y evestido de laca inhibidora de soldadura
- Tarjeta de circuito impreso de adaptación para aprox. 40 distintas carcasas QFP, SOP, SSOP, SDIP
- QFP- 0,80 mm Pitch: 44, 56, 64, 72, 80, 94, 100, 120-Pin
- QFP- 0,85 mm Pitch: 48, 54, 56, 64, 68, 80, 100-Pin
- QFP- 0,50 mm Pitch: 48, 64, 72, 80, 100, 120, 144, 160-Pin
- SOP- 1,27 mm Pitch: máx. 44 clavijas en 225, 300, 375, 450, 525, 600 mil.
- SOP- 1,00 mm Pitch: máx. 36 clavijas en 225, 300, 375 mil.
- SSOP- 0,80 mm Pitch: máx. 42 clavijas en 300, 450 mil.
- SSOP- 0,65 mm Pitch: máx. 30 clavijas en 225, 300 mil.
- SDIP- 1,778 mm Raster: máx. 64 clavijas en 300, 400, 500, 600, 750 mil.
- Tamaño 100 x 160 mm